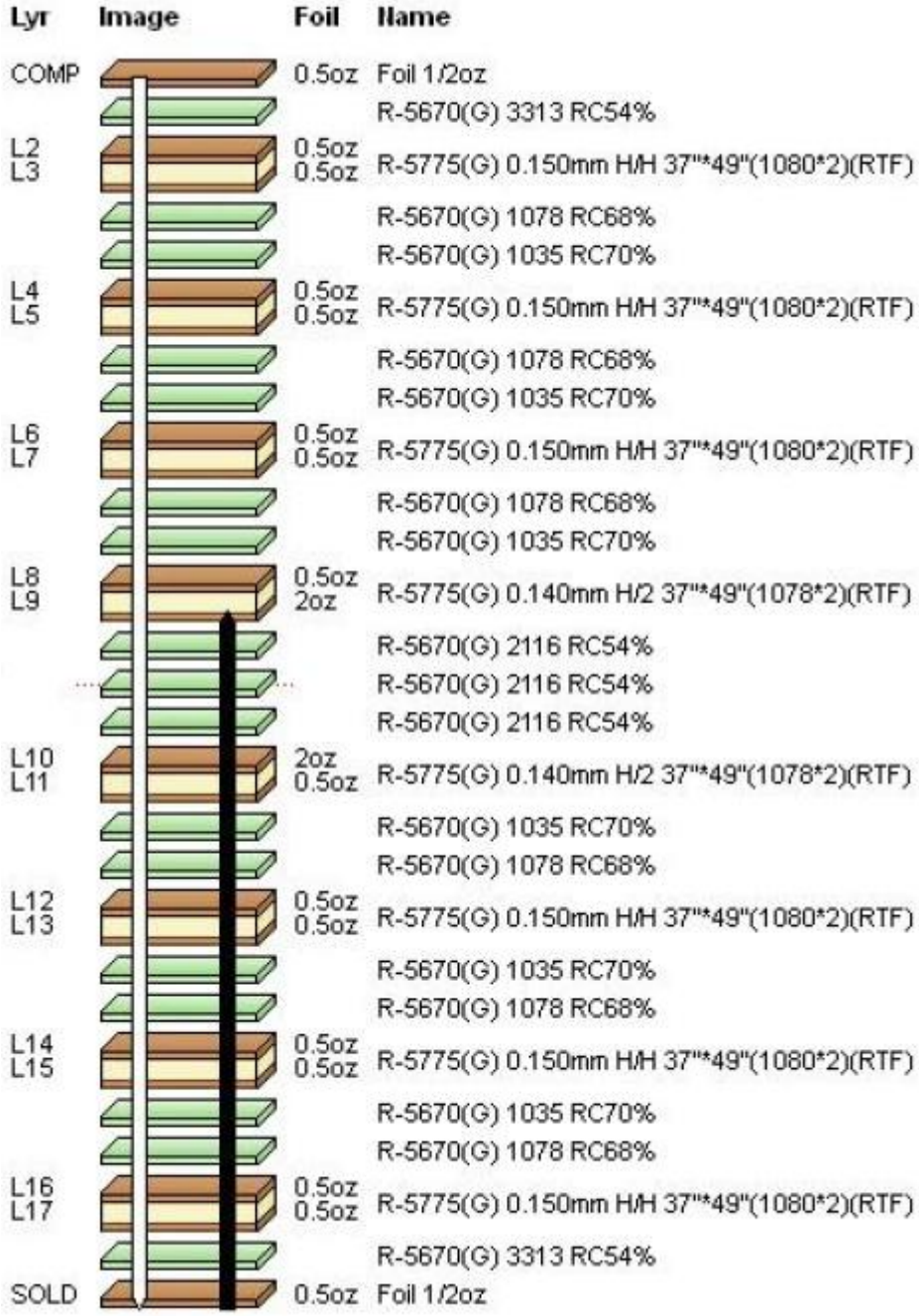
Copper Plate holes Minimum .025 AVG,. 020 min. Löcher dürfen nicht eingesteckt werden
• besondere Anforderung: EniG, harte Gold-Stärke: 4UM, Impedanz: Tol: +/-7%, die Abweichung der Impedanz in der gleichen Schicht darf nicht überschreiten +/-2 Ohm, Back Drill, gedreht 7 Grad.

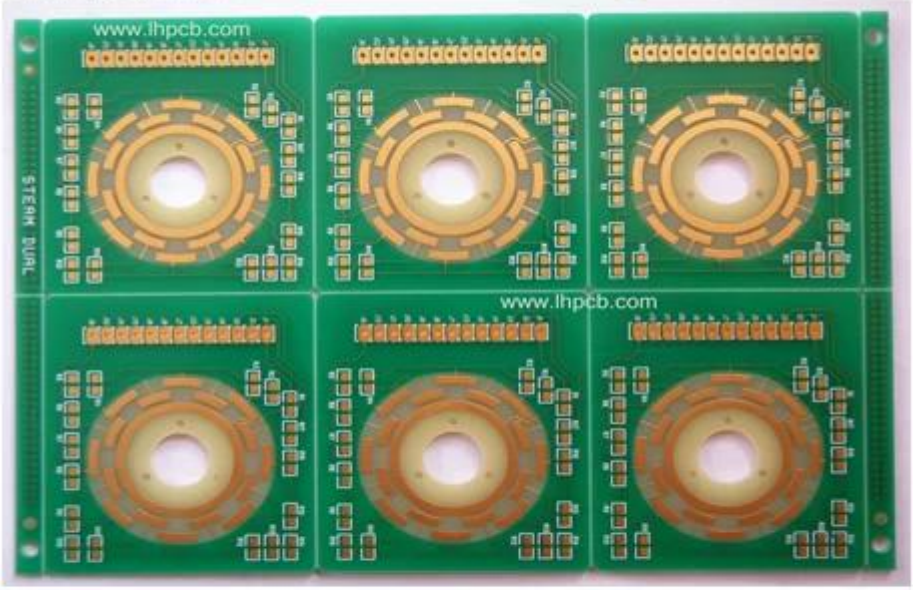
Pack mit colorless transparent Bubble Film, 25 Stk/Tasche, Put desiccant in Flanke, Put feuchte Indikator-Karte auf der Oberseite

Layer-Struktur



O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

HDI PCB Printed Circuit Board, China PCB-Fertigung